



### **Toshiba présentera une solution de stockage multimédia à l'échelle du pétaoctet à l'occasion d'IBC**

Démonstration en direct sur le stand Toshiba – en présence des partenaires disponibles

**Paris, France, 12 Septembre 2023** – Toshiba Electronics Europe GmbH (Toshiba) participera à l'International Broadcasting Convention (IBC) qui se déroulera du 15 au 18 septembre. A cette occasion, outre les produits exposés sur son stand, Toshiba présentera, par le biais d'une démonstration en direct, une solution de stockage basée sur des disques durs (HDD) haute capacité et hautes performances. Destinée aux applications multimédias et basée sur les disques durs Toshiba MG10 de 20 To, le système atteint jusqu'à 1,2 pétaoctet (1 200 To) de stockage brut.

Dans le stockage de médias numériques, les besoins en capacité augmentent continuellement. Ceci en raison de la quantité et de la résolution des médias stockés. Les séquences vidéo et audio nécessitent un stockage étendu au coût par capacité le plus bas possible, mais toujours à une vitesse de lecture et d'écriture élevée. L'innovation continue dans la technologie des disques durs et dans l'architecture et les composants du système environnants signifie que les solutions basées sur les disques durs resteront la technologie privilégiée pour un stockage multimédia volumineux et rentable.

Cette année, sur son stand, Toshiba réalisera une démonstration en direct d'un système de stockage complet hautes performances et haute capacité, basé sur ses disques durs phares.

Le système comprendra :

- Disque dur SAS Enterprise 20 To MG10SCA20TE de Toshiba
- Promise JBOD VTrak J5960 à 60 baies
- Adaptateurs de bus hôte ATTO ESAH-12 SAS/SATA
- Cartes réseau ATTO FFRM-N4 100 GbE
- Logiciel SDS basé sur JovianDSS ZFS d'Open-E
- Serveur SB202-TU PcieExpress Gen4 d'AIC

Au cœur du système se trouveront 60 disques durs Toshiba SAS MG10SCA de 3,5 pouces et 20 To. La série MG10 bénéficie de la conception Toshiba de quatrième génération à 10 disques scellés à l'hélium pour faire progresser la densité d'enregistrement magnétique conventionnel (CMR) à 2 To par disque.

Ces 60 disques durs fonctionnent très efficacement dans un JBOD Promise VTrak J5960, connecté au serveur de contrôle du nœud principal à l'aide des adaptateurs de bus hôte SAS ESAH-12 d'ATTO. Sur le serveur de nœud principal AIC SB202-TU, le logiciel JovianDSS d'Open-E implémente un pool ZFS fournissant des cibles iSCSI et des dossiers partagés via un réseau 100GbE basé sur les cartes NIC FFRM-N4 d'ATTO.

IBC 2023 est l'endroit où l'avenir de l'industrie mondiale des médias et du divertissement est défini et mis en œuvre, réunissant les communautés créatives, technologiques et commerciales pour collaborer, apprendre et créer de nouvelles opportunités.

Toshiba se trouve dans le hall 6, stand 6.A27, où son équipe et les spécialistes d'[Open-E](#) et de [Promise](#) seront disponibles pour discuter de la démonstration en direct. [ATTO](#) fournira son assistance depuis son stand 7.A26 dans le hall 7.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits de stockage sur disque dur de Toshiba, veuillez visiter [www.toshiba-storage.com](http://www.toshiba-storage.com).

###

### À propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre aux consommateurs et aux entreprises d'Europe une grande variété de lecteurs de disques durs (hard disk drive, HDD) ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour l'automobile, l'industrie, l'IoT, le contrôle de mouvement, les télécommunications, les réseaux, la grande consommation et les produits blancs. Outre les disques durs, le vaste portefeuille de l'entreprise comprend des semi-conducteurs de puissance et d'autres composants discrets allant des diodes aux circuits intégrés logiques et aux semi-conducteurs optiques, ainsi que des microcontrôleurs et des produits standard spécifiques à l'application (*application specific standard products*, ASSP), entre autres.

En outre, TEE propose également les cellules et modules de batterie SCiB™ de Toshiba à l'oxyde de lithium-titane (LTO) pour les applications les plus exigeantes et les substrats céramiques en nitrure de silicium (SiN) utilisés dans les modules semi-conducteurs de puissance, les onduleurs et les convertisseurs pour leurs caractéristiques de dissipation thermique et leur résistance.

TEE a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, et des succursales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni qui fournissent des services de marketing, de vente et de logistique.

Visitez les sites Web de Toshiba à [www.toshiba-storage.com](http://www.toshiba-storage.com), [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com), [www.scib.jp/en](http://www.scib.jp/en) et [www.toshiba-tmat.co.jp/en/](http://www.toshiba-tmat.co.jp/en/) pour plus d'informations sur la société et ses produits.

**Contact pour publication :**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tél : +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web : [www.toshiba-storage.com](http://www.toshiba-storage.com) [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com)

E-mail : [marcom@tee.toshiba.de](mailto:marcom@tee.toshiba.de)

**Contact presse :**

Miriam Theissen, Toshiba Electronics Europe GmbH

E-mail : [MTheissen@tee.toshiba.de](mailto:MTheissen@tee.toshiba.de)

**Contact presse France :**

Audrey Lacroix

Tel: +33 (0) 6 14 40 15 81

E-mail: [lacroix.audrey@alcommunication.fr](mailto:lacroix.audrey@alcommunication.fr)